

未來科技展推動辦公室 函

地 址：台北市松山區八德路三段 2 號 3 樓
電 話：(02)2577-4249 分機 233
傳 真：(02)2578-6427
承辦人：邱喬昕

受文者：台灣區表面處理工業同業公會

發文日期：107 年 11 月 20 日

發文字號：（107）未字第 0004 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：亮點技術手冊

主旨：檢送科技部「2018 未來科技展」活動資訊，惠請貴單位踴躍參觀並轉知所屬，請查照。

說明：

- 一、為盤點前瞻科研成果，展現我國科技實力，聚焦產業及社經需求，以搭建技術交易媒合平台，科技部於 107 年 12 月 13 日（四）至 12 月 15 日（六）10：00~18：00 假台北世界貿易中心展覽三館（台北市信義區松壽路 6 號）辦理未來科技展，並委由台北市電腦公會執行。
- 二、本展集結全國學界科研成果、科學園區、國家實驗研究院、同步輻射中心、災害防救中心等研發成果，匯集全國 101 家學研單位參與，展出 123 件具科學突破與產業應用的前瞻技術，包含生技與新藥、醫材、AI 智慧應用、電子與光電、金屬化工與新穎材料等應用領域，展現創新研發能量，引領臺灣未來十年科技浪潮，接軌國際；現場另規劃有「量子電腦」、「智慧醫院」、「人文科技」3 大特色專區，展現科技部在前瞻技術上的研發能量與產業應用特色，邀請日美國際重量級產業專家舉辦 AI 人工智慧、精準醫療基因解密、量子電腦引爆技術革命等主題趨勢論壇，誠摯邀請貴單位組團參觀，體驗創新研發能量。
- 三、活動內容請參閱附件亮點技術手冊，請惠予將活動訊息轉知所屬會員與同仁，活動網站及團體參觀報名：<http://www.futuretech.org.tw>，活動詳情請洽詢未來科技展推動辦公室(02)2577-4249 分機 233 邱喬昕小姐。

台灣區表面處理工業同業公會
收文 107306 號
民國 107 年 12 月 4 日

未來科技展推動辦公室